

## 展示会出展のご案内

アジア最大級！電子機器・半導体・  
パワーデバイスなど最新技術を1,800社が出展

第  
39  
回

# ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

日時 2025年 1月22日[水]~24日[金] 10:00~17:00

会場 東京ビッグサイト 東展示棟

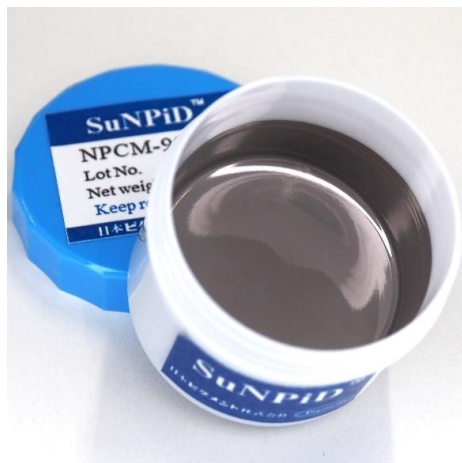
日本ピグメント(株)は東7ホールE68-35にて出展します。

### 銀焼結接合材

SuNPiD®

#### パワー半導体向け接合材料

自社開発銀ナノ粒子による高接合強度、高放熱性、高信頼性、ボイドレスが特長の製品です。

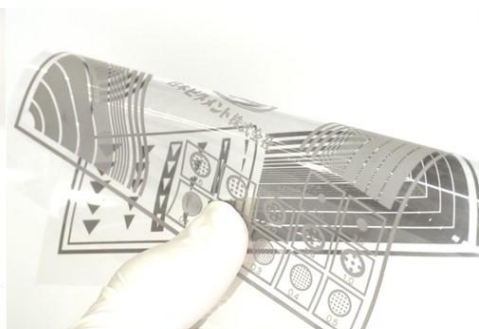


### 導電性印刷インキ

SuNPiD®

#### フレキシブル基板向け導電性材料

スクリーン印刷用途、一液硬化型、良好な電気特性、耐溶剤性が特長の製品です。



Pigment

日本ピグメント株式会社